



[kingston.com/embedded](http://kingston.com/embedded)

## Automotive-Temp DDR3/3L DRAM

### 适用于扩展的更高温度的嵌入式应用的理想内存

Kingston Automotive-Temp 离散 DRAM 设计为满足需要更大操作温度范围的嵌入式应用的需求。它提供低电压选项，实现低功耗。设备工作温度范围为 -40°C 至 +105°C，因而成为恶劣环境、户外标志、监控、工厂自动化、交通、服务器、触摸屏亭和其他极端环境嵌入式应用的理想存储解决方案。

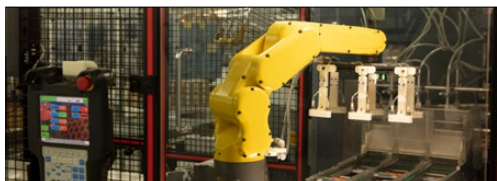
市场细分



信息娱乐嵌入式应用



户外应用：标识牌/自助服务终端/太阳能逆变器/充电器



工业物联网 / 机器人和工厂自动化



高清视频、会议和监视系统



充电站/太阳能逆变器

AUTOMOTIVE-TEMP DDR3/DDR3L 产品型号和规格

产品型号	容量	描述	封装尺寸	配置 (Words x Bits)	速度 Mbps	VDD、VDDQ	工作温度
D1216ECMDXGMEY	2Gb	96 ball FBGA DDR3/DDR3L	13.5x7.5x1.2	128Mx16	2133 Mbps	1.35V*	-40°C ~ +105°C
D2516ECMDXGMEY	4Gb	96 ball FBGA DDR3/DDR3L	13.5x7.5x1.2	256Mx16	2133 Mbps	1.35V*	-40°C ~ +105°C

\*向后兼容 1.5V VDD、VDDQ

主要特性

- 长期支持 - 延长产品使用寿命
- 交付时间短 - 在任何市场条件下可用
- 稳定、可靠且成熟的模具工艺 - 一次性合格 (无需模具修订)
- 兼容性 - 所有支持 DDR3 和 DDR3L 的主要嵌入式 SOC (系统芯片) \*
- Kingston 品牌 - 全球公认的质量、可靠性、服务和支持

\*符合 JEDEC DDR3/DDR3L 行业标准

